

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-73

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**第五届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年12月5日上午10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议主持人：董事长陈奇星。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-75）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，相关意见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案**

为满足公司项目建设和生产经营资金需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司申请新增 22 亿元综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及子公司共同使用。

以上授信额度申请计划是公司及相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案**

经审议，董事会同意公司为深圳市梦启半导体装备有限公司（以下简称“梦启半导体”）的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 1,000 万元。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效之日起 5 年。

梦启半导体申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求梦启半导体的其他股东按其持股比例提供相应担保。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-76）。

公司独立董事已对此事项发表独立意见，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月五日